# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT.
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



#### PCI

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EĬGENTUM Internationales Būro

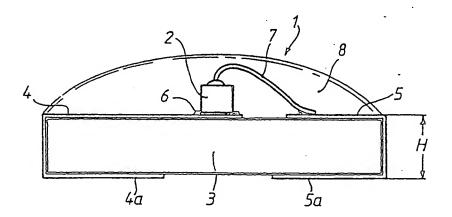


# INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation <sup>3</sup> :		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 83/00408
H01L 31/02, 33/00	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. Februar 1983 (03.02.83)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/E. (22) Internationales Anmeldedatum: 16. Juli 1982	•	Mit internationalem Recherchenbericht.
(31) Prioritätsaktenzeichen: P 3	1 28 18	7.7
(32) Prioritätsdatum: 16. Juli 1981	(16.07.	1)
(33) Prioritätsland:	]	DE
(71)(72) Anmelder und Erfinder: SIEG, Joachim [I Königsberger Str. 18, D-8068 Pfaffenhofen (		
(74) Anwalt: TETZNER, Volkmar; Van-Gogh-S 8000 München 71 (DE).	Str. 3,	D-
(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent ropäisches Patent), CH (europäisches Patent ropäisches Patent), FR (europäisches Patent ropäisches Patent), JP, NL (europäisches Patent), US.	), DE ( ), GB (	ou- ou-

(54) Title: OPTOELECTRONIC COMPONENT

(54) Bezeichnung: OPTO-ELEKTRONISCHES BAUELEMENT



#### (57) Abstract

The optoelectronic component (1) is comprised of a semiconductor body (2), a support (3), two connections (4, 5) and a coating layer (8). A component of this type may be readily used for various applications.

#### (57) Zusammenfassung

Opto-elektronisches Bauelement (1) mit einem Halbleiterkörper (2), einem Träger (3), zwei Anschlüssen (4, 5) und einer abdeckenden Schicht (8). Ein solches Bauelement gestattet eine einfache Herstellung beliebiger anwendungstechnischer Anordnungen durch den Anwender.

BNSDOCID: <WO\_\_\_8300408A1\_L>

## LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	KΡ	Demokratische Volksrepublik Korea
ΑÜ	Australien	LI	Liechtenstein
BE .	Belgien	Ĺĸ	Sri Lanka
BR	Brusilien	ίΰ	Luxemburg
CF	Zentrale Afrikanische Republik	MC	Monaco
CG	Kongo	MG	Madagaskar
CH	Schweiz	MW	Malawi
CM	Kamerun	NL	Niederlande
DΕ	Deutschland, Bundesrepublik	NO	orwegen
DΚ	Dänemark	RO	Rumania
FI	Finnland	SE	Schweden
FR	Frankreich	SN	Seneval
GA	Gabun	SL	Soviet Union
GB	Vereinigtes Königreich	TD	Tschad
HĽ.	l'ngurn	TG	Togo
JP	Japan	is	Vereinigte Staaten von Amerika

10

15

20

25

- 1 -

### Opto-elektronisches Bauelement

Licht emittierende Halbleiter (LED) sowie lichtempfindliche Halbleiter werden üblicherweise in einem Verband hergestellt, mit Spezialmaschinen in Einzel-Chips (mit einer Kantenlänge von ca. 0,3 mm) getrennt, mit einem Spezialwerkzeug abgenommen und dann auf ein Trägermaterial, beispielsweise eine gedruckte Schaltungsplatte aufgebracht. Zur Kontaktierung werden mit einem Bondungsgerät die Anschlüsse angebracht, was ein sehr komplizierter und kritischer Arbeitsgang ist, der großes Know-how und hohe Investitionen erfordert. Die Bondstelle muß ferner schnell abgedeckt werden, um mechanische und atmosphärische Einflüsse zu verhindern.

Diese übliche Verarbeitungstechnik von Licht emittierenden und lichtempfindlichen Halbleitern bedeutet in der Praxis, daß eine derartige Verarbeitung nur von großen Spezialfirmen und in hohen Stückzahlen durchgeführt werden kann. Sonderanfertigungen sind kaum oder nur mit hohen Kosten möglich. Hierauf beruht es, daß die bisher üblichen LED-Anzeigen weitgehend standardisiert sind, beispielsweise 7-Segment-Anzeigen zur Zifferndarstellung, 16-Segment-Anzeigen zur alphanumerischen Anzeige, Leuchtdioden als Punkte bzw. als kleine Symbole usw.

Für den Anwender besteht daher nur ein ganz geringer

Spielraum in der Display-Gestaltung. Spezialanzeigen,
die auf die jeweilige Applikation zugeschnitten

sind, erfordern im Hinblick auf die eingangs geschil-



1	derte	Verarbeitungstechnik	einen	ungewöhnlich	arosen
	Aufwan	ıd.		,	arone!

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, unter Vermeidung dieser Nachteile ein opto-elektronisches Bauelement zu schaffen, das mit geringem fertigungstechnischen Aufwand (und damit im Bedarfsfalle vom Anwender selbst) zur Herstellung beliebiger anwendungstechnischer Formen verwendet werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein optoelektronisches Bauelement gelöst, das gekennzeichnet ist durch

- a) einen opto-elektronischen Halbleiterkörper,
  - b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Träger für diesen Halbleiterkörper,
- c) zwei auf dem Träger flächig aufgebrachte, mit dem Halbleiterkörper verbundene Anschlüsse, die sich von der den Halbleiterkörper tragenden Außenfläche des Trägers bis auf die gegenüberliegende Außenfläche des Trägers erstrecken und dort eine Anschlußkontaktfläche bilden,
  - d) eine den Halbleiterkörper und seine Verbindung mit den beiden Anschlüssen abdeckende lichtdurchlässige Schicht.

Erfindungsgemäß wird somit der opto-elektronische Halbleiterkörper in einem ersten Arbeitsgang in

5

10

15

eine gut handliche Bausteinform gebracht. In diesem ersten Arbeitsgang erfolgt u.a. der eingangs erwähnte, kritische Schritt des Bondens. Insofern ist es von wesentlicher wirtschaftlicher Bedeutung, daß die Gestaltung des opto-elektronischen Bauelementes in diesem ersten Arbeitsgang noch völlig anwender-unabhängig ist. Die Fertigung dieses opto-elektronischen Bauelements kann infolgedessen standardisiert in großen Stückzahlen und demgemäß sehr wirtschaftlich erfolgen.

Da bei dem so geschaffenen opto-elektronischen Bauelement der Halbleiterkörper und seine Verbindung
mit den beiden Anschlüssen, insbesondere der Bonddraht, durch eine lichtdurchlässige Schicht abgedeckt und einwandfrei geschützt ist, sind beim Versand und bei der weiteren Handhabung dieses Bauelementes keine besonderen Vorsichtsmaßregeln erforderlich.

20

25

30

Von besonderem Vorteil ist nun, daß der Anwender mit einem derartigen Bauelement auf einfachste Weise beliebige Displays und opto-elektronische Anordnungen zusammenstellen kann. Hierfür ist besonders wesentlich, daß die erfindungsgemäße Gestaltung der Anschlüsse, die auf der einen Außenfläche des Isoliermaterial-Trägers je eine Anschlußkontakt-fläche bilden, auf einfachste Weise die Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen diesem Bauelement und einer größeren Schaltungsanordnung gestattet. Der Anwender braucht somit lediglich die erfindungsgemäßen Bauelemente in der von ihm ge-



1	wünschten Anordnung auf eine gedruckte Schaltungs-
	platte aufzusetzen und durch einen einfachen töt-
	oder Klebvorgang anzuschließen. Er kann auf diese Weise selbst komplizierteste Display-Anordnungen,
5	die evtl. nur in vergleichsweise geringen Stückgab
	len benötigt werden, mühelos zusammenstellen.

Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche und werden im Zusammenhang mit der Beschreibung einiger in der Zeichnung veranschaulichter Ausführungsbeispiele näher erläutert.

In der Zeichnung zeigen

15

10

- Fig.1 eine Seitenansicht eines ersten Ausführungsbeispieles eines erfindungsgemäßen optoelektronischen Bauelementes;
- 20 Fig.2 eine Aufsicht auf das Bauelement gemäß Fig.1;
  - Fig. 3 und 4 Seitenansicht und Aufsicht eines zweiten Ausführungsbeispieles;

- Fig.5 bis 8 Schemadarstellungen einiger Anwendungsmöglichkeiten des erfindungsgemäßen Bauelementes.
- Das in den Fig.1 und 2 dargestellte opto-elektronische Bauelement 1 enthält einen opto-elektronischen Halbleiterkörper 2 (z.B. ein LED), einen aus Isolier-



20

material, vorzugsweise aus Keramik, bestehenden Träger 3, zwei auf dem Träger 3 flächig aufgebrachte Anschlüsse 4 und 5, die sich bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel von der den Halbleiterkörper 2 tragenden Breitseite des Trägers über die beiden Stirnseiten auf die andere Breitseite des Trägers erstrecken und dort je eine Anschlußkontaktfläche 4a bzw. 5a bilden.

Die Unterseite des Halbleiterkörpers 2 ist durch einen leitenden Kleber 6 flächig mit dem Anschluß 4 verbunden. Die Oberseite des Halbleiterkörpers 2 steht über einen Verbindungsdraht, den sog. Bonddraht 7, mit dem anderen Anschluß 5 in Verbindung.

Bei dem in den Fig.1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ist der Halbleiterkörper 2 erhaben auf der oberen Breitseite des Trägers 3 angeordnet. Eine lichtdurchlässige, vorzugsweise aus Epoxydharz bestehende Schicht 8 deckt die ganze, den Halbleiterkörper 2 tragende Breitseite des Trägers 3 ab und schützt damit den Halbleiterkörper 2, den Bonddraht 7 sowie die Anschlüsse 4 und 5.

Der Träger 3 ist quaderförmig ausgebildet. Seine Breite B beträgt maximal 1,27 mm und entspricht damit dem Rastermaß (1/10") üblicher gedruckter Schaltungen. Die Länge L des Trägers 3 beträgt beim dargestellten Ausführungsbeispiel etwa 3,2 mm, die Höhe H etwa 0,6 mm.



Die den Halbleiterkörper 2 abdeckende Schicht 8 aus Epoxydharz ist domartig gewölbt. Sie kann entweder farblos-lichtdurchlässig oder farbig sein. Je nach dem Anwendungszweck kann es ferner erwünscht sein, der Schicht 8 lichtstreuende Eigenschaften zu geben.

> Die beiden Anschlüsse 4 und 5 können eine unterschiedliche Länge erhalten, um dem Anwender eine zuverlässige Unterscheidung zu ermöglichen.

10

15

20

25

Bei dem in den Fig.3 und 4 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel ist der Träger 3' mit einer Vertiefung 3'a versehen, in der der Halbleiterkörper 2' angeordnet ist. Die beiden Anschlüsse 4' und 5' bestehen aus je zwei auf den beiden Breitseiten des Trägers 3' vorgesehenen Anschlußteilen 4'a, 4'b bzw. 5'a, 5'b sowie aus einem die beiden Anschlußteile verbindenden, durch einen Durchbruch 9 bzw. 10 des Trägers 3' hindurchgreifenden Leiterelement 4'c bzw. 5'c.

Der Halbleiterkörper 2' ist durch einen Kleber 6' mit dem Anschluß 4' und über einen Bonddraht 7' mit dem Anschluß 5' verbunden. Die Vertiefung 3'a ist durch eine Schicht 8' aus Epoxydharz abgedeckt.

Die Fig.5 bis 8 veranschaulichen einige Möglichkeiten zur Anwendung des erfindungsgemäßen Bauelementes.

30

Fig.5 zeigt einen Teil einer Leiterplatte 11 mit aufgedruckten Leiterbahnen 12, auf die zwei opto-



elektronische Bauelemente 1 und 1a aufgesetzt sind.

Im Falle des Bauelementes 1 steht somit die Anschlußkontaktfläche 4a (vgl. Fig.1) beispielsweise in Verbindung mit der Leiterbahn 12a und die Anschlußkontaktfläche 5a (Fig.1) in Verbindung mit der Leiterbahn 12b. Die Herstellung dieser Anschlußverbindung
zwischen den Bauelementen 1, 1a und den Leiterbahnen
12 erfolgt in üblicher Weise durch Löten oder mittels
eines Leitklebers.

10

15

Über den beiden opto-elektronischen Bauelementen 1, 1a ist ein Reflektor 13 angeordnet, der an seiner Oberseite beispielsweise eine Beschriftung 14 trägt. Der Reflektor 13 ist beim dargestellten Ausführungsbeispiel mit Steckerstiften 15 auf der Leiterplatte 11 befestigt.

Fig.6 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel einer Leiterplatte 16 mit darauf vorgesehenen Leiter
20 bahnen 17 und elektrischen Bauteilen 18. An einer Stelle des dargestellten Ausschnittes der Leiterplatte ist ein erfindungsgemäßes opto-elektronisches Bauelement 1 vorgesehen, über dem ein Reflektor 19 angebracht ist.

25

30

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig.7 trägt die Leiterplatte 20 u.a. einen Drucktaster 21 und ein opto-elektronisches Bauelement 1. Über der Leiterplatte 20 und den von ihr getragenen Bauteilen ist eine Abdeckfolie 22 vorgesehen.



- 8 -

1	Fig.8 zeigt in ganz schematischer Form eine Ein-
	richtung zum Lesen eines Lochstreifens bzw. einer
	Lochschait 22 to Thes Lochstreifens bzw. einer
	Lochscheibe 23. Auf der einen Seite ist als Sende
	ein Licht emittierendes Bauelement 1 und auf der
5	anderen Seite als Empfänger ein lichtempfindliches
	Pauclement 1
	Bauelement 1a vorgesehen. Diese beiden Bauelemente
	sind hier mit ihren Anschlußkontaktflächen (z.B.
	anschlußkontaktflächen (z.B.
	4a, 5a, vgl. Fig.1) auf Metallstifte 24, 25 bay
	24a, 25a aufgesetzt und hiermit verlötet bzw. lei-
10	tond world in
10	tend verklebt.

Während bei den beschriebenen Ausführungsbeispielen der Träger aus keramischem Material besteht, ist es im Rahmen der Erfindung auch möglich, ihn aus Glas oder emalliertem Stahl herzustellen. Der Träger muß ferner nicht exakt quaderförmig sein, sondern kann beispielsweise an den beiden Stirnseiten Einbuchtungen aufweisen, durch die die Anschlüsse von der einen zur anderen Außenfläche verlaufen.

20

15

25



- g -

### 1 Patentansprüche:

1.	Opto-elektronisches					es	Bauelement,				ent,				
	g	e	k	e	n	n	z	e	i	С	h	n	е	t	durch

5

- a) einen opto-elektronischen Halbleiterkörper (2),
- b) einen aus Isoliermaterial bestehenden Träger(3) für diesen Halbleiterkörper,

10

c) zwei auf dem Träger (3) flächig aufgebrachte, mit dem Halbleiterkörper (2) verbundene Anschlüsse (4, 5), die sich von der den Halbleiterkörper tragenden Außenfläche des Trägers (3) bis auf die gegenüberliegende Außenfläche des Trägers erstrecken und dort eine Anschlußkontaktfläche (4a bzw. 5a) bilden,

15 Ω

> d) eine den Halbleiterkörper (2) und seine Verbindung mit den beiden Anschlüssen (4, 5) abdeckende lichtdurchlässige Schicht (8).

20

2. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper eine Licht emittierende Diode (LED) ist.

25

3. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper ein lichtempfindliches Halbleiterelement ist.



- 4. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der/quaderförmige Träger (3) eine
  Breite von maximal 1,27 mm aufweist.
- 5. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterseite des Halbleiterkörpers (2) durch einen leitenden Kleber (6) flächig
  mit dem einen Anschluß (4) und die Oberseite des
  Halbleiterkörpers über einen Verbindungsdraht
  (Bonddraht 7) mit dem anderen Anschluß (5) verbunden ist.
- 6. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die beiden Anschlüsse (4, 5) von der den Halbleiterkörper (2) tragenden einen Breitseite des Trägers (3) über die beiden Stirnseiten des Trägers hinweg bis zur anderen Breitseite des Trägers erstrecken und dort je eine Anschlußkontaktfläche (4a, 5a) bilden.
  - 7. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Anschlüsse (4', 5') aus je zwei auf den beiden Breitseiten des Trägers (3') vorgesehenen Anschlußteilen (4'a, 4'b, 5'a, 5'b) sowie einem die beiden Anschlußteile verbindenden, durch einen Durchbruch (9, 10) des Trägers (3') hindurchgreifenden Leiterelement (4'c, 5'c) bestehen.
- 8. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterkörper (2) erhaben auf einer Breitseite des Trägers (3) angeordnet ist.

-11. -

1	9.	Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
		net, daß der Halbleiterkörper (2') in einer auf
		der einen Breitseite des Trägers (3') vorgesehener
		Vertiefung (3'a) angeordnet ist.

5

10. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die den Halbleiterkörper (2) sowie den zwischen dem Halbleiterkörper und dem einen Anschluß (5) vorhandenen Verbindungsdraht (7) abdeckende lichtdurchlässige Schicht (8) aus Epoxydharz besteht.

15

20

30

- 11. Bauelement nach den Ansprüchen 8 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die aus Epoxydharz bestehende Schicht (8) die ganze den Halbleiterkörper (2) tragende Breitseite des Trägers (3) abdeckt.
- 12. Bauelement nach den Ansprüchen 9 und 10, dadurch gekennzeichnet, daß die aus Epoxydharz bestehende Schicht (8') die den Halbleiterkörper (2') aufnehmende Vertiefung (3'a) abdeckt.
- 13. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (3) aus Keramikmaterial besteht.
  - 14. Bauelement nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (3) eine Länge von 3,2 mm, eine Breite von 1,27 mm und eine Höhe von 0,6 mm aufweist.



1	15. Bauelement nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
	zeichnet, daß die den Halbleiterkörper (2) ab-
	deckende Schicht (8) aus Epoxydharz domartig
	gewölbt ist.

16. Bauelement nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die den Halbleiterkörper abdeckende Schicht farbig ist.

10

17. Bauelement nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die den Halbleiterkörper abdeckende Schicht lichtstreuende Eigenschaften besitzt.

15

18. Bauelement nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen aufgesetzten Reflektor (13).

19. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Anschlüsse (4, 5) eine unterschiedliche Länge aufweisen.

20

20. Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger aus Glas besteht.

25

21.Bauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger aus emailliertem Stahl besteht.

FIG.1

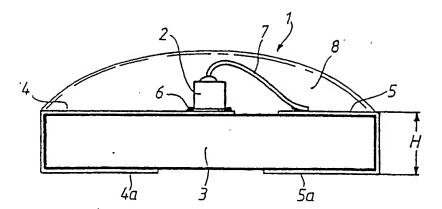


FIG.2

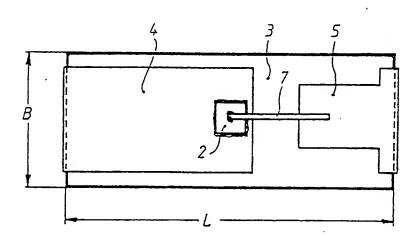


FIG. 3

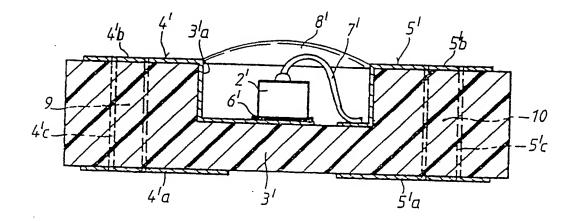
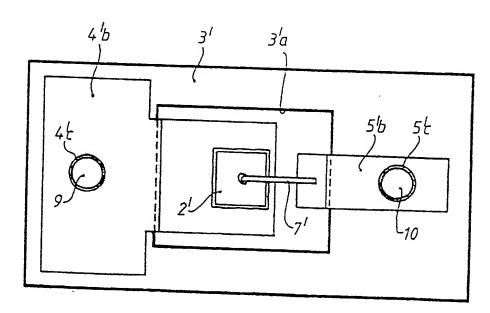


FIG.4





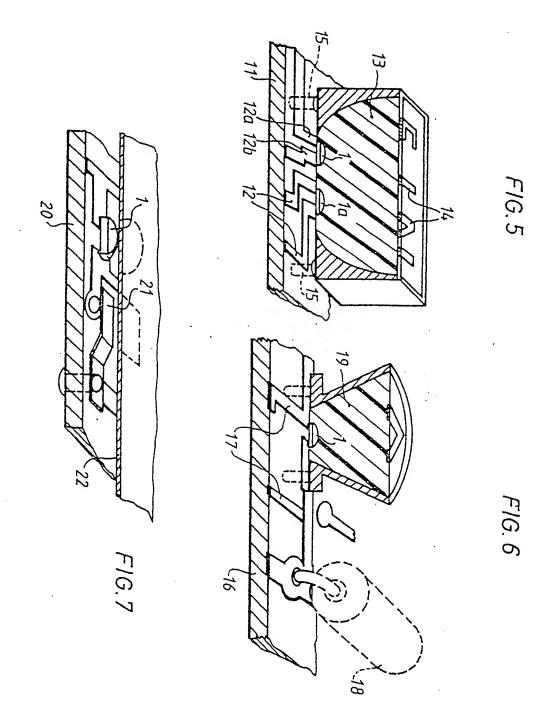
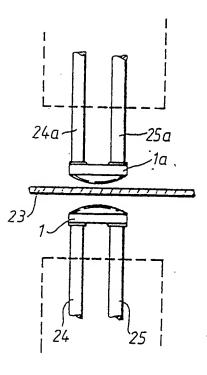


FIG. 8





# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeicnen PCT/EP 82/00153

	I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassilikationssymbolen sind alle anzugeben)*				
1	. Kl. 3	alen Paleniklassilikation (IPC) oder nach der n			
	VT -	H-01 L 31/02; H	от г 33/00		
II. HECHE	RCHIERTE	SACHGEBIETE	Mindestpruistoli*		
Klassilikai	onssystem	righter (merter	Klassilikationssymbole		
Int.	.Kl. <sup>3</sup>	H 01 L	<u> </u>		
		Recherchierte nicht zum Mindestprufstoff unter die recherchier	gehorende Verollentlichungen, soweit die: ien Sachgebiete fallen <sup>‡</sup>	Se	
III. EINSC	HLAGIGE	VEROFFENTLICHUNGEN"			
Art*		nnung der Verallentlichung, soweit erlorderlic	h unter Angabe der Maßgeblichen Teile <sup>17</sup>	Betr Anspruch Nr. "	
Y	US,	A, 4168102 (TAKEO CHI 1979 siehe Spalten 1 und 2	_	1,2,7,8,18	
. <b>Y</b>	GB,	A, 1258660 (ISAO HORI siehe Seite 3, Zeilen 6	E) 31 Dezember 1969 50-70; Abbildung	1,6,13	
Ā	FR,	A, 1490665 (J. THILLA siehe Seiten 4,5; Abb		1,2,10,11,15	
A	CA,	A, 1016679 (S.C. FOWL siehe Seite 5, Abbild	ER) 30 August 1977 ung 2	1,2,5,9	
A	DE,	A, 2227322 (W. SCHÖBE 1973 siehe Seiten 2,3; Abb		1,2,15,17	
A	GB,	A, 2002959 (J.C. THIL	LAYS) 28 Februar	-/.	
"A" Ver del "E" alte nat "L" Ver zwi olfd ger ein ger	roffentlichu iniert, aber eres Dokum ironalen Ani roffentlichungs erfelhalt ers entlichungs nannten Ver em anderer ivnrt)	orien von angegebenen Verollentlichungen" ng, die den alligemeinen Stand der Technik nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist ent, das jedoch erst am oder nach dem inter- meldedatum verollentlicht worden ist ng, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch scheinen zu lassen, oder durch die das Ver- idatum einer anderen im Recherchenbericht offentlichung belegt werden soll oder die aus n besonderen Grund angegeben ist (wie aus-	"I" Spatere Veröffentlichung, die nac meldecatum oder dem Prioritats den ist und mit der Anmeldung ni zum Verstandnis des der Erlin Prinzips oder der ihr zugrundeliben ist.  "X" Veröffentlichung von besondere spruchte Erlindung kann nicht ir ischer Tatigkeit beruhand betract.  "Y" Veröffentlichung von besondere spruchte Erlindung kann nicht all	datum veroffentlicht wor- cott kollidiert, Sondern nur dung zugrundeliegenden egenden Theorie angege- er Bedautung; die bean- als neu oder auf erfinde- chtet werden er Bedautung; die bean- s auf erfinderischer Tatig-	
b. Aei	rollenticnu rollenticnu	ng, die sich auf eine mundliche Offenbarung, g. eine Ausstellung oder andere Maßnahmen ng die vor dem internationalen Anmeideda- ih dem beanspruchten Prioritalsdatum ver-	keil berunend betrachtet werden, mit einer oder menreren anderei ser Kategorie in Verbindung geb bindung für einen Fachmann nah "&" Veröffentlichung, die Mitglied dei	n Verollentlichungen die- racht wird und diese Ver- ieliegend ist	
0110	entlicht wor	den ist		$\Delta$	
	EINIGUNG Abschiuss	es der internationalen Recherche	Absendedatum des totales and and		
\		ober 1982	Absendedatum des internationalen Rec		
Internation	nale Recne	chenbenorde'	Unterschrift des bevollmachtigten Bedi	ensieten	
	Euro	päisches Patentamt	G.L.M. Kruydent	Y 1 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Oktober 1981)

Art <sup>-</sup>	Kennzeichnung der Veröffentlichung, 16 soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Te	ile " Betr Anspruch Nr 14
	1979 siehe Zusammenfassung und Abbildung 1	1,2,10,15, 16
A	GB, A, 1440274 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC) 23. Juni 1976 siehe Seiten 2,3; Abbildungen 1-5	1,2,8-10
A	DE, A, 2650770 (S. YOSHITAKA) 18.Mai 197 siehe Seiten 14,15; Abbildung 2	
A	US, A, 3911430 (A.S. JANKOWSKI) 7. Oktob	er
	1975 siehe Zusammenfassung, Abbildungen 3 bis 5	1,2,5,8, 10,11,15, 18
		10
	ii a	
	·	
	·	
	•	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 82/00153

international Application No PCI/EF 82/00155						
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER (If several class					
	to International Patent Classification (IPC) or to both Na	tional Classification and IPC				
Int. C	Cl. <sup>3</sup> : H01 L 31/02; H 01 L 33/00					
II. FIELD	S SEARCHED					
	Minimum Docume	ntation Searched 4	<del></del>			
Classificati	on System	Classification Symbols				
Int. C	n.3 H 01 L	•				
	Documentation Searched other to the Extent that such Document	than Minimum Documentation a are included in the Fields Soarched 6				
Catogory •	Citation of Document, 16 with Indication, where app	reportate of the relevant passages 17	Relevant to Claim No. 16			
32100017	Chandr of Boedinghe, 19 with indication, whore ap-	graphical or the research passages	Tradavant to Grant 140, 13			
Y	US, A, 4168102 (TAKEO CHIDA) 18 Septe figures 1, 2	mber 1979, see columns 1 and 2,	1, 2, 7, 8, 18			
Y	GB, A, 1258660 (ISAO HORIE) 31 Decemb	er 1969, see page 3, lines 50-70;	1, 6, 13			
Y	FR, A. 1490665 (J. THILLAYS) 04 August	- 1967, sée pages 4, 5; figure 1	1, 2, 10, 11, 15			
A	CA, A, 1016679 (S. C. FOWLER) 30 August	1977, see page 5, figure 2	1, 2, 5, 9			
A	DE, A, 2227322 (W. SCHÖBERL) 13 December 1973; see pages 2, 3; figure 1 1, 2, 15, 17					
A	GB, A, 2002959 (J. C. THILLAYS) 28 Febr	uary 1979, see abstract and figure l	1, 2, 10, 15, 16			
Α ;	GB, A, 1440274 (TOKYO SHIBAURA ELE 2, 3; figures 1-5	CTRIC) 23 June 1976, see pages	1, 2, 8-10			
Α,	DE, A, 2650770 (S. YOSHITAKA) 18 May	1977, see pages 14, 15; figure 2	1,2,3			
A	US, A, 3911430 (A. S. JANKOWSKI) 07 Octobro 5	ctober 1975, see abstract, figures 3	1, 2, 5, 8, 10, 11, 15 18			
ļ	•		•			
i		;	:			
į						
"A" doce	I categories of cited documents: 15 ument defining the genoral state of the art which is not pidered to be of particular relevance	"T" later document published after th or priority date and not in conflic cited to understand the principle invention	t with the application but			
นแต	er document but published on or after the international g date	"X" document of particular relevanc	e; the claimed invention cannot be considered to			
WILL	document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step					
CITET O'' doci	which is cited to obtablish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  """ document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined being obvious to a person skilled					
"P"- doct	"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "4" document member of the same patent family					
	FICATION					
	Actual Completion of the International Search 3	Date of Mailing of this international Sec	arch Report *			
18 00	ctober 1982 (18.10.82)	08 November 1982 (08.11.8	2)			
Internation	al Searching Authority 1	Signature of Authorized Officer 10				
Euro	pean Patent Office	<b>V</b>				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (October 1981)

DOCKET NO: 1999 P 17/1
SERIAL NO: 10/007, 398
AFPLICANT: Sorg
AFPLICANT: Sorg LERNER AND G. ENBERG P.A.
P.O. BOX 2480
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
TEL. (954) 925-1100
·